



平成27年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年5月11日 東

上場会社名 テクノクオーツ株式会社 上場取引所
 コード番号 5217 URL <http://www.techno-q.com>
 代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 根 辰 男
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 小 野 文 男 (TEL) 03-5354-8171
 定時株主総会開催予定日 平成27年6月19日 配当支払開始予定日 平成27年6月22日
 有価証券報告書提出予定日 平成27年6月22日
 決算補足説明資料作成の有無 : 有
 決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成27年3月期の連結業績(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(1) 連結経営成績 (%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年3月期	5,177	△15.3	218	△71.5	263	△64.5	132	△69.7
26年3月期	6,114	32.8	766	57.2	742	45.3	438	59.1

(注) 包括利益 27年3月期 404百万円(△52.9%) 26年3月期 859百万円(91.2%)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
27年3月期	17.16	—	2.0	2.9	4.2
26年3月期	56.59	—	7.2	8.7	12.5

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
27年3月期	8,766	6,795	77.5	877.96
26年3月期	9,330	6,468	69.3	835.64

(参考) 自己資本 27年3月期 6,795百万円 26年3月期 6,468百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
27年3月期	573	△320	△383	1,366
26年3月期	200	△26	100	1,412

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産 配当率 (連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
26年3月期	—	0.00	—	10.00	10.00	77	17.7	1.3
27年3月期	—	0.00	—	5.00	5.00	38	29.1	0.6
28年3月期(予想)	—	0.00	—	5.00	5.00		42.9	

3. 平成28年3月期の連結業績予想(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	2,598	12.6	80	158.4	73	3.4	43	6.3	5.55
通 期	5,200	0.4	159	△27.0	143	△45.5	90	△32.1	11.65

※ 注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
 ② ①以外の会計方針の変更 : 無
 ③ 会計上の見積りの変更 : 無
 ④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	27年3月期	7,800,000株	26年3月期	7,800,000株
② 期末自己株式数	27年3月期	59,779株	26年3月期	59,779株
③ 期中平均株式数	27年3月期	7,740,221株	26年3月期	7,740,221株

(参考) 個別業績の概要

1. 平成27年3月期の個別業績（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

(1) 個別経営成績 (%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年3月期	5,052	△16.3	181	△73.8	265	△66.4	135	△70.0
26年3月期	6,037	31.5	693	87.0	790	81.7	452	85.8
	1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益					
	円 銭		円 銭					
27年3月期	17.53		—					
26年3月期	58.52		—					

(2) 個別財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円	%	百万円	%	%	円 銭	%	
27年3月期	8,221		6,105		74.3	788.81		
26年3月期	8,901		6,016		67.6	777.26		

(参考) 自己資本 27年3月期 6,105百万円 26年3月期 6,016百万円

2. 平成28年3月期の個別業績予想（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭	
第2四半期(累計)	2,598	15.5	70	295.0	77	12.0	49	2.2	6.40	
通期	5,200	2.9	136	△25.1	135	△49.2	86	△36.3	11.17	

※ 監査手続の実施状況に関する表示

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。上記予想に関する事項は、決算短信[添付資料]2ページ「次期の見通し」をご参照ください。

○添付資料の目次

1. 経営成績・財政状態に関する分析	2
(1) 経営成績に関する分析	2
(2) 財政状態に関する分析	3
(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当	4
2. 経営方針	4
(1) 会社の経営の基本方針	4
(2) 目標とする経営指標	5
(3) 中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題	5
3. 会計基準の選択に関する基本的な考え方	5
4. 連結財務諸表	6
(1) 連結貸借対照表	6
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書	8
(3) 連結株主資本等変動計算書	10
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書	12
(5) 連結財務諸表に関する注記事項	13
(継続企業の前提に関する注記)	13
(セグメント情報)	13
(1株当たり情報)	15
(重要な後発事象)	15
5. 補足情報	16
(1) 生産、受注及び販売の状況	16

1. 経営成績・財政状態に関する分析

(1) 経営成績に関する分析

①当期の経営成績

当連結会計年度(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)におけるわが国経済は、消費税増税の影響が一巡し、政府の新たな景気対策の効果や、これまでの円安進行による輸出の持ち直しなどで、景気は緩やかに回復傾向にあります。一方で、ギリシャ問題や中国をはじめとする新興国経済の減速懸念や原油安が新たな混乱要素となり、景気の先行きは不透明な状況が続いております。

当社グループが属する半導体業界におきましては、スマートフォンやタブレット端末の好調な需要に支えられ、台湾のファウンドリ、中国、韓国等で設備投資が継続しています。

このような環境の中、当社グループの半導体製造プロセスの前工程で使われる消耗品(石英・シリコン製品)につきましては、国内市場は厳しい状況が続いていますが事業再編が一段落し、受注・売上高ともに徐々に回復しつつあります。

一方、海外市場では、設備投資が継続し受注は第2四半期(7月～9月)から第3四半期(10月～12月)にかけて回復しましたが、昨年と比較すると設備投資が小規模になり売上高は昨年を下回りました。

損益面につきましては、売上高の減少と円安の影響による原材料コストの上昇により、前連結会計年度比で減益となりました。

以上の結果、売上高は5,177百万円(前連結会計年度15.3%減)、営業利益は218百万円(同71.5%減)、経常利益は263百万円(同64.5%減)、当期純利益132百万円(同69.7%減)となりました。

セグメント別の受注高等は次のとおりであります。

半導体事業の受注高は、前連結会計年度比で17.2%減少して5,120百万円となりました。アジア地域を中心にメモリーの増産や微細化投資が昨年と比較すると低水準で推移したため、海外市場での受注が前連結会計年度比30.7%減少となりました。

受注は第2四半期から第3四半期にかけて増加し、第4四半期では顧客の設備投資が一巡して調整気味となりました。期末の受注残高は1,267百万円(前連結会計年度比14.2%増)と前期末比では増加しました。

なお、その他の事業の受注高は222百万円(同10.1%減)となり、受注残高は26百万円(同44.5%増)となりました。

半導体事業の売上高は4,962百万円(同15.4%減)となりました。内訳としては石英製品が4,071百万円(同7.5%増)となり、シリコン製品は891百万円(同57.2%減)となりました。

また、その他の事業の売上高は214百万円(同12.6%減)となりました。

損益面では売上高の減少により、半導体事業の売上総利益1,413百万円(同36.0%減)となり、その他の事業は13百万円の損失(前連結会計年度は15百万円の損失)となりました。販売費及び一般管理費を控除した全体での営業利益は218百万円(前連結会計年度比71.5%減)となりました。

②次期の見通し

次期の見通しにつきましては、新興国経済の動向や円安に伴う原材料価格の上昇等による影響が懸念されており、先行き不透明な状況が続くものの、賃金上昇などによる個人消費の持ち直し、政府の新たな経済対策の効果で国内市場の景気は回復基調が続くことが予想されます。

半導体業界におきましては、引き続きスマートフォン、タブレット端末市場が設備投資の需要を牽引するものと考えております。しかし、需要の牽引役は高級機種の一巡感から、廉価品へとシフトすることが予想され、従来にも増して短納期化や低価格化の顧客要求が高まることを見込まれるなど、業界全体としては厳しい経営環境が続くものと思われまます。

このような状況下、当社グループは、既存顧客の深耕を図ると共に、成長が見込まれるアジアや米国地域を中心に新規需要の開拓に努めます。また、450mmウエハや微細化投資等の顧客ニーズに対応すると共に、引き続き原価低減を推進してまいります。

以上のことから、平成28年3月期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)の通期連結業績につきましては、売上高5,200百万円(前連結会計年度比0.4%増)、営業利益159百万円(同27.0%減)、経常利益143百万円(同45.5%減)、当期純利益90百万円(同32.1%減)を見込んでおります。

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

(資産の状況)

当連結会計年度末の財政状態は、総資産が前連結会計年度末に比べ564百万円減少して8,766百万円となりました。主な要因は受取手形及び売掛金が753百万円減少し、たな卸資産が122百万円増加したことなどによるものです。

(負債の状況)

負債は、前連結会計年度末に比べ891百万円減少して1,970百万円となりました。主な要因は借入金290百万円、未払法人税等が305百万円、その他流動負債が210百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。

(純資産の状況)

純資産は、前連結会計年度末に比べ327百万円増加して6,795百万円となりました。主な要因は利益剰余金が55百万円、為替換算調整勘定が240百万円それぞれ増加したことなどによるものであります。

なお、自己資本比率は77.5%となっております。

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末に比べ45百万円減少し1,366百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な増減要因は、以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は573百万円(前連結会計年度に対して373百万円の増加)となりました。

これは主に税金等調整前当期純利益261百万円の計上、減価償却費417百万円、売上債権の減少781百万円、たな卸資産の増加61百万円、仕入債務の減少118百万円、法人税等の支払445百万円などによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は320百万円(前連結会計年度に対して293百万円の減少)となりました。

これは主に有形固定資産の取得による支出307百万円などによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における財務活動による資金の減少は383百万円(前連結会計年度に対して484百万円の減少)となりました。

これは主に長期借入金の返済による支出289百万円、配当金の支払額77百万円などによるものであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成23年3月期	平成24年3月期	平成25年3月期	平成26年3月期	平成27年3月期
自己資本比率(%)	65.0	68.5	73.0	69.3	77.5
時価ベースの 自己資本比率(%)	39.2	40.4	42.8	36.4	41.7
キャッシュ・フロー 対有利子負債比率(%)	6.8	2.2	1.2	7.2	2.0
インタレスト・ カバレッジ・レシオ(倍)	10.3	32.2	50.0	12.1	38.0

(注) 自己資本比率：自己資本÷総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額÷総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債÷営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー÷利払い

1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

2. 株式時価総額は、期末株式終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しております。

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、株主の皆様に対する安定的な利益還元を経営の重要課題として認識しております。また、急速な技術革新に対応した設備投資、競争力の維持・強化を図るための財務体質の強化に努めるとともに、長期的な視野に立った配当水準の向上に取り組む方針であります。

平成27年3月期の配当につきましては、上記方針に基づき、期末配当金として1株当たり5円を予定し、本年6月に開催予定の定時株主総会に付議することにしております。

なお、次期の配当につきましては、現状での次期業績見通しを勘案し、1株当たり5円(期末配当)を計画しております。

2. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

当社グループの付加価値経営計画の主体は人であり、人(社員)を中心として経営計画を組み立てております。

当社は親会社であるジーエルサイエンス株式会社(東京証券取引所市場第二部7705)の連結対象子会社として創立以来経営の基本理念を共有しております。

親会社は昭和43年の創立の際に、会社はどのような思想を持ち、実践していくかという、経営に対する姿勢、理念を「創立の根本精神及び経営理念」に掲げました。その中で創立の目的は、「同一の思想を持ち、信頼し合う事のできる人間が集まって、何かの仕事を通じて経済的無から、一つの理想体(理想企業体)を作り上げる事への挑戦」と謳っております。

この親会社の「創立の根本精神及び経営理念」により、当社も「社会に対し社会性を充分発揮してその存在価値を高め、社員個々の幸福を勝ち取り、企業の維持、発展をならしめること」を基本理念として活動しております。

(2) 目標とする経営指標

経営の基本方針に記載している基本理念を実現していくために、当社では創立以来毎期、付加価値経営計画の全容を社員に発表してまいりました。このようなオープンな経営姿勢に対する社員個々の意識の高まりが、互いの信頼感を強くし、個々の能力を十分に活かすことで、計画達成という一つの目的に邁進することができたと確信しております。

このように、「道は一つ、共に進もう」という当社のスローガンに沿った付加価値経営こそが躍進の原動力であり、今後も成長の糧としてまいります。

付加価値は6項目の構成要素からなっております。

その経営指標は①人件費58.5%、②福利厚生費1.3%、③金融費用2.0%、④動産不動産賃借料2.7%、⑤減価償却費13.0%、⑥付加価値内利益(営業利益－金融費用)22.5%としております。また、付加価値を生み出す売上高は3項目で構成され、①材料原価44.0%、②付加価値合計43.0%、③その他一般経費13.0%で構成されております。

(3) 中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題

半導体関連業界は、世界的規模ではこれまで成長を牽引してきたパソコン、携帯電話やTVなど民生機器が減速を示し、一方でスマートフォン、タブレット端末など高機能アプリケーションの展開により市場全体が牽引され、今後も穏やかに成長を維持すると期待されます。

また、国内半導体メーカーの国内市場が縮小したことによる混乱も一段落し、回復の兆しが見えてきました。海外大手半導体メーカーは引き続き微細化を含めた設備投資計画を発表しています。このような半導体市場の急激かつ構造的な変化の中、当社グループの成長戦略を下記に示します。

- ・ 国際化促進と市場ボーダーレス化への対応の為、中国を含むアジアへの展開を強化し、更なる事業拡大を図ります。
- ・ 急速に進んでいる半導体製造装置の微細化に対応する為、早急に加工技術の開発推進及び設備の充実を図ります。
- ・ 新設した製品開発部を中心として既存分野のシェアアップにとどまらず、技術革新により新規分野（低反射ステージ露光装置部品、パワー半導体等）への参入を図り、安定的経営を目指します。
- ・ 超精密加工技術（メディカル等）、拡散接合技術等の技術を高度化し、当社独自のコア・コンピタンスを創出することで技術革新を図り、他社との差別化を図ります。
- ・ リードタイムの短縮、品質の向上、コストダウン等の徹底したゼロベースでの生産革新により、製造原価の低減に努めます。
- ・ 中国子会社及び国内工場の生産設備の見直しにより生産能力の向上を図ります。これにより全体の生産能力向上はもとより、東日本大震災の様な災害時における緊急な生産相互補完能力を強化します。

3. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は日本基準で連結財務諸表を作成する方針であります。

なお、IFRSの適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。

4. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当連結会計年度 (平成27年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,723,254	1,677,314
受取手形及び売掛金	2,582,730	1,829,679
製品	150,469	183,034
仕掛品	465,838	449,305
原材料及び貯蔵品	515,384	621,936
繰延税金資産	81,326	42,255
その他	148,100	226,390
貸倒引当金	△2,618	△1,836
流動資産合計	5,664,486	5,028,078
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	3,368,212	3,507,867
減価償却累計額	△2,201,860	△2,340,102
建物及び構築物(純額)	1,166,351	1,167,765
機械装置及び運搬具	3,863,442	4,373,159
減価償却累計額	△2,854,426	△3,219,615
機械装置及び運搬具(純額)	1,009,015	1,153,544
土地	985,336	985,336
リース資産	114,622	112,113
減価償却累計額	△55,962	△68,389
リース資産(純額)	58,659	43,724
建設仮勘定	108,946	8,630
その他	327,661	355,220
減価償却累計額	△271,340	△306,464
その他(純額)	56,320	48,755
有形固定資産合計	3,384,630	3,407,757
無形固定資産	51,558	49,067
投資その他の資産		
投資有価証券	118,397	164,198
長期貸付金	8,790	8,365
その他	104,238	109,798
貸倒引当金	△1,909	△1,153
投資その他の資産合計	229,517	281,208
固定資産合計	3,665,706	3,738,033
資産合計	9,330,193	8,766,112

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当連結会計年度 (平成27年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	415,502	345,532
短期借入金	823,961	808,680
リース債務	15,681	15,681
未払法人税等	313,097	7,643
賞与引当金	90,344	78,172
その他	431,308	220,849
流動負債合計	2,089,894	1,476,558
固定負債		
長期借入金	619,259	343,819
リース債務	45,910	30,229
繰延税金負債	4,189	15,989
役員退職慰労引当金	18,625	20,922
退職給付に係る負債	83,338	82,035
資産除去債務	922	922
固定負債合計	772,245	493,918
負債合計	2,862,140	1,970,477
純資産の部		
株主資本		
資本金	829,350	829,350
資本剰余金	1,015,260	1,015,260
利益剰余金	4,211,521	4,267,011
自己株式	△32,608	△32,608
株主資本合計	6,023,524	6,079,014
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	9,111	40,260
為替換算調整勘定	435,416	676,360
その他の包括利益累計額合計	444,528	716,620
純資産合計	6,468,053	6,795,634
負債純資産合計	9,330,193	8,766,112

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
売上高	6,114,309	5,177,582
売上原価	3,921,933	3,776,759
売上総利益	2,192,375	1,400,823
販売費及び一般管理費		
給料及び手当	257,119	247,165
賞与引当金繰入額	33,296	28,725
退職給付費用	9,745	8,269
役員退職慰労引当金繰入額	6,437	7,560
その他	1,119,474	891,063
販売費及び一般管理費合計	1,426,073	1,182,783
営業利益	766,302	218,039
営業外収益		
受取利息	826	688
受取配当金	1,969	2,182
為替差益	—	54,367
その他	15,944	8,099
営業外収益合計	18,740	65,338
営業外費用		
支払利息	16,323	15,239
為替差損	25,252	—
その他	1,409	4,513
営業外費用合計	42,984	19,752
経常利益	742,058	263,625
特別利益		
固定資産売却益	—	367
特別利益合計	—	367
特別損失		
固定資産売却損	—	52
固定資産除却損	5,421	2,121
特別損失合計	5,421	2,174
税金等調整前当期純利益	736,637	261,817
法人税、住民税及び事業税	330,975	90,298
法人税等調整額	△32,398	38,627
法人税等合計	298,576	128,926
少数株主損益調整前当期純利益	438,060	132,891
当期純利益	438,060	132,891

連結包括利益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	438,060	132,891
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,100	31,148
為替換算調整勘定	420,410	240,943
その他の包括利益合計	421,510	272,092
包括利益	859,570	404,983
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	859,570	404,983

(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	829,350	1,015,260	3,827,643	△32,608	5,639,645
当期変動額					
剰余金の配当			△54,181		△54,181
当期純利益			438,060		438,060
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	383,878	—	383,878
当期末残高	829,350	1,015,260	4,211,521	△32,608	6,023,524

	その他の包括利益累計額			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算調整勘定	その他の包括利益 累計額合計	
当期首残高	8,010	15,006	23,017	5,662,663
当期変動額				
剰余金の配当				△54,181
当期純利益				438,060
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	1,100	420,410	421,510	421,510
当期変動額合計	1,100	420,410	421,510	805,389
当期末残高	9,111	435,416	444,528	6,468,053

当連結会計年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	829,350	1,015,260	4,211,521	△32,608	6,023,524
当期変動額					
剰余金の配当			△77,402		△77,402
当期純利益			132,891		132,891
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	—	—	55,489	—	55,489
当期末残高	829,350	1,015,260	4,267,011	△32,608	6,079,014

	その他の包括利益累計額			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算調整勘定	その他の包括利益 累計額合計	
当期首残高	9,111	435,416	444,528	6,468,053
当期変動額				
剰余金の配当				△77,402
当期純利益				132,891
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）	31,148	240,943	272,092	272,092
当期変動額合計	31,148	240,943	272,092	327,581
当期末残高	40,260	676,360	716,620	6,795,634

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	736,637	261,817
減価償却費	392,581	417,273
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	790	△1,685
賞与引当金の増減額 (△は減少)	16,034	△12,172
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	2,181	△1,302
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	6,437	2,297
受取利息及び受取配当金	△2,796	△2,871
支払利息	16,323	15,239
為替差損益 (△は益)	32,200	△33,137
固定資産売却損益 (△は益)	—	△314
固定資産除却損	5,421	2,121
売上債権の増減額 (△は増加)	△1,032,478	781,283
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△142,032	△61,318
仕入債務の増減額 (△は減少)	157,638	△118,084
その他	107,876	△218,158
小計	296,814	1,030,988
利息及び配当金の受取額	2,873	2,847
利息の支払額	△16,537	△15,092
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△82,709	△445,003
営業活動によるキャッシュ・フロー	200,440	573,740
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△169,000	△156,000
定期預金の払戻による収入	256,000	156,000
有形固定資産の取得による支出	△301,436	△307,727
有形固定資産の売却による収入	—	500
無形固定資産の取得による支出	△1,011	△2,222
投資有価証券の取得による支出	△2,372	△2,434
貸付けによる支出	△4,230	△1,290
貸付金の回収による収入	1,110	1,715
その他	194,018	△8,663
投資活動によるキャッシュ・フロー	△26,922	△320,122
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	50,240	△760
長期借入れによる収入	400,000	—
長期借入金の返済による支出	△277,952	△289,961
リース債務の返済による支出	△17,829	△15,681
配当金の支払額	△53,944	△77,527
財務活動によるキャッシュ・フロー	100,514	△383,929
現金及び現金同等物に係る換算差額	46,083	84,371
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	320,116	△45,940
現金及び現金同等物の期首残高	1,092,137	1,412,254
現金及び現金同等物の期末残高	1,412,254	1,366,314

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

1. 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの取扱い製品で、それぞれ独立した財務情報の入手が可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定や業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループの事業内容は、半導体製造工程の前工程において、半導体製造装置内で使用される消耗品の製造とその販売であります。当該製品の売上高は全売上高の9割以上を占めているため、半導体事業を報告セグメントとしております。

2. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法と概ね同一であります。

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント		その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	連結財務諸 表計上額 (注3)
	半導体	計				
売上高						
外部顧客への売上高	5,868,684	5,868,684	245,624	6,114,309	—	6,114,309
計	5,868,684	5,868,684	245,624	6,114,309	—	6,114,309
セグメント利益又は損失(△)	2,207,731	2,207,731	△15,355	2,192,375	△1,426,073	766,302
セグメント資産	5,958,459	5,958,459	18,177	5,976,636	3,353,556	9,330,193
その他の項目						
減価償却費	353,217	353,217	—	353,217	39,363	392,581
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	326,293	326,293	—	326,293	1,055	327,348

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、理化学機器等の製造・販売等を含んでおります。

2. 調整額は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又は損失の調整額は、販売費及び一般管理費であります。

(2) セグメント資産の調整額は、全社資産であり、余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

3. セグメント利益又は損失の調整額は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント		その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	連結財務諸 表計上額 (注3)
	半導体	計				
売上高						
外部顧客への売上高	4,962,976	4,962,976	214,606	5,177,582	—	5,177,582
計	4,962,976	4,962,976	214,606	5,177,582	—	5,177,582
セグメント利益又は損失(△)	1,413,989	1,413,989	△13,166	1,400,823	△1,182,783	218,039
セグメント資産	5,378,841	5,378,841	18,945	5,397,786	3,368,325	8,766,112
その他の項目						
減価償却費	381,694	381,694	—	381,694	35,579	417,273
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	325,543	325,543	—	325,543	1,654	327,198

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、理化学機器等の製造・販売等を含んでおります。

2. 調整額は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又は損失の調整額は、販売費及び一般管理費であります。

(2) セグメント資産の調整額は、全社資産であり、余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

3. セグメント利益又は損失の調整額は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(1株当たり情報)

前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	
1株当たり純資産額	835円64銭	1株当たり純資産額	877円96銭
1株当たり当期純利益	56円59銭	1株当たり当期純利益	17円16銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
連結損益計算書上の当期純利益	438,060千円	連結損益計算書上の当期純利益	132,891千円
普通株式に係る当期純利益	438,060千円	普通株式に係る当期純利益	132,891千円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	7,740,221株	普通株式の期中平均株式数	7,740,221株

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

5. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	生産高(千円)	前年同期比(%)
半導体	5,078,567	△12.0
その他	119,135	1.8
合計	5,197,702	△11.8

- (注) 1. 金額は販売価格によっております。
2. 金額は消費税等を含んでおりません。

② 受注実績

当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	受注高(千円)	前年同期比(%)	受注残高(千円)	前年同期比(%)
半導体	5,120,775	△17.2	1,267,583	14.2
その他	222,643	△10.1	26,094	44.5
合計	5,343,418	△16.9	1,293,677	14.7

- (注) 金額は消費税等を含んでおりません。

③ 販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	販売高(千円)	前年同期比(%)
半導体	4,962,976	△15.4
その他	214,606	△12.6
合計	5,177,582	△15.3

- (注) 1. 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先	前連結会計年度(千円)	割合(%)	当連結会計年度(千円)	割合(%)
Applied Materials, Inc.	2,056,586	33.6	1,760,517	34.0

2. 金額は消費税等を含んでおりません。